

## 武汉农尚环境股份有限公司

### 关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意武汉芯连微电子有限公司、苏州内夏半导体有限责任公司（以下简称“苏州内夏”）、深圳市中自芯连技术有限公司向银行申请合计最高不超过（含本数）6,000 万元的综合授信额度，并由公司为该授信提供连带责任担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定；于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易事项的议案》，公司控股股东海南芯联微科技有限公司、实际控制人林峰先生同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。

公司控股子公司苏州内夏与江苏银行股份有限公司苏州分行（以下简称“江苏银行苏州分行”）于 2023 年 9 月 22 日签订了《流动资金借款合同》（合同编号：XW100051433523092200001），江苏银行苏州分行向苏州内夏提供人民币 1,000 万元的流动资金贷款额度；同时，公司与江苏银行苏州分行签订《最高额连带责任保证书》，由公司为苏州内夏上述借款提供连带责任保证担保。

上述事项具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日、9 月 15 日、9 月 25 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 二、担保进展情况

苏州内夏拟继续向江苏银行苏州分行申请综合授信敞口不超过 300 万元，借款到期日 2025 年 7 月 15 日。公司及实际控制人林峰先生为苏州内夏向江苏银行苏州

分行申请综合授信事项提供连带责任保证，担保期限为自该笔借款履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保及对外担保预计的公告》。本次担保事项在已审议通过的担保额度范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保方基本情况

#### 1. 基本情况

公司名称	苏州内夏半导体有限责任公司
法定代表人	龚树峰
注册资本	10,000 万元
注册地址	苏州高新区金山东路 78 号 1 幢 Z101 室三层 313
成立日期	2020-01-10
主营业务	一般项目：集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；专业设计服务；半导体器件专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电工仪器仪表销售；金属材料销售；电子产品销售；显示器件销售；光电子器件销售；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	公司全资子公司武汉芯连微持股 51%，韩国 Nexia Device Co., LTD 持股 49%
是否为失信被执行人	否

#### 2. 最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日
资产总额	5,721.77	5,512.32
负债总额	3,763.61	2,793.83
净资产	1,958.16	2,718.49
	2023 年度	2024 年 1-6 月
营业收入	0	1,018.87
利润总额	-1,228.14	558.09

净利润	-1,245.83	560.32
-----	-----------	--------

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司已签订对外担保合同总额为 1,000 万元人民币，担保余额为 600 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.00%。公司及控股子公司未对合并报表范围外的主体单位提供担保，亦不存在逾期、涉及诉讼的对外担保情形。

特此公告

武汉农尚环境股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日